

安全处理器 1756-EN2TR 环保高效

产品名称	安全处理器 1756-EN2TR 环保高效
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	638.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-EN2TR 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

安全处理器 1756-EN2TR 环保高效

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

安全处理器 1756-EN2TR 环保高效

向电动汽车的加速转型推动汽车充电系统取得了重要的创新成果，这愈发需要更具成本效益的高性能功率电子器件。为此，英飞凌科技股份有限公司（FSE代码：IFX / OTCQX代码：IFNNY）推出QDPAK封装，进一步扩展其650 V CoolMOS CFD7A产品阵容。与行业熟知的TO247 THD器件相比，采用QDPAK封装的产品系列具有同等的散热能力，但电气性能更高，能够在车载充电器和DC-DC转换器中实现高效的能源利用。

650 V CoolMOS CFD7A

高效且强大的电动汽车充电系统有助于缩短充电时间、减轻汽车重量、提高设计灵活性并降低汽车的总体拥有成本。这一新产品系列通过顶部和底部冷却封装实现了多种功能和优势特性，是对现有CoolMOS CFD7A产品系列的有效补充。QDPAK TSC（顶部冷却）封装使设计人员能够实现更高的功率密度和更佳的PCB空间利用率。

650 V CoolMOS CFD7A提供了支持在高压应用中可靠运行的多项重要功能。由于降低了寄生电感，该器件可以大程度地减少电磁干扰（EMI），确保清晰的信号和稳定的性能。开尔文源极引脚提高了电流检测的精度，即使在恶劣条件下也能保证测量的准确性。该器件具有适合高压应用的爬电距离，以及在25 °C温度环境下高达694 W的大电流能力和高功率耗散（ P_{tot} ）能力，是一款适用于各种高压应用的强大通用器件。

采用基于QDPAK TSC封装的650 V CoolMOS CFD7A器件，进行新系统设计，将大限度地利用PCB空间，使功率密度加倍，并通过板级去耦加强散热管理。这种方法简化了装配、避免了电路板堆叠，并减少了对[连接器](#)的需求，从而降低了系统成本。该电源开关可降低高达35%的热阻，提供比标准冷却解决方案更优的高功率耗散能力。

该特性克服了在底部冷却SMD设计中采用FR4 PCB所带来的热限制，显著提高了系统性能。经过优化的电源环路设计将驱动器置于电源开关附近，通过降低杂散电感和芯片温度来提高可靠性。总之，这些特性有助于构建一个具有高成本效益、稳健、高效的系统，能够很好地满足现代化的充电需求。

正如2023年2月所宣布的，适合高功率应用的QDPAK TSC封装已注册为JEDEC标准，通过统一的标准封装设计和占板面积，推动TSC封装在新型设计中的广泛采用。为进一步加快这一转型，英飞凌还将于2024年发布更多用于车载充电器和DC-DC转换器的、采用QDPAK TSC封装的车规级器件，例如750 V CoolSiC器件和1200 V CoolSiC器件等。

供货情况

650 V CoolMOS CFD7A器件采用了QDPAK封装，共有两个版本，分别采用了顶部冷却（TSC）封装和底部冷却（BSC）封装两种形式。

安全处理器 1756-EN2TR 环保高效